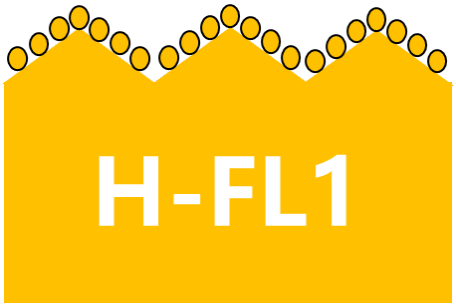
适配板材

★ 中高Tg无卤环氧

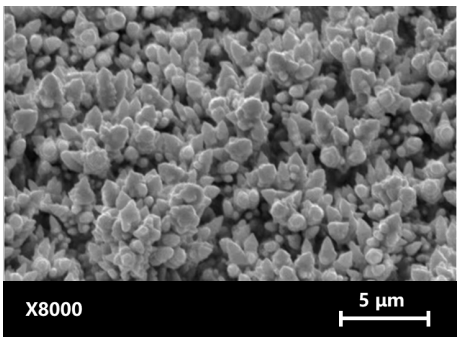
★ BT/ 类BT



典型应用

★ 精细线路

★ HDI高密度互联



技术指标

项目		单位	物性参数	测试方法
标称厚度		μm	12	IPC-4562A
单位面积质量		g/m²	107	IPC-TM-650 2.2.12
抗拉强度	常温	MPa	400	IPC-TM-650 2.4.18
	180℃		200	
延伸率	常温	%	5.0	
	180℃		4.0	
粗糙度 Rz	压合面	μm	4.5	IPC-TM-650 2.2.17
	阻剂面		1.7	
剥离强度	FR4	lb/inch	5.0	IPC-TM-650 2.4.8

★ 以上数据为典型值，非保证值。

★ 半固化片会影响剥离强度，铜箔使用前请进行半固化片匹配实验或咨询德福科技技术服务人员。